

## • 복리후생



### 글로벌 역량 강화

화상 및 전화 외국어, 외국어 Intensive 과정  
사내 TOEIC, JPT 시험, 직무 교육 등



### 경력개발 프로그램 및 보상 제도

해외파견 등 글로벌 업무 경험, CDP(직무순환제도) 운영, 개인별  
업무관리목표(MBO)를 통한 코칭과 성과에 따른 합리적인 보상



### 금융 지원

사내 세마을금고 입점, 주택자금, 생활안정자금, 경조금, 자녀  
장학금 지원 등



### 의료 지원

건강관리실, 근골격계센터, 전문 심리상담실, 종합검진지원  
의사방문 및 무료 진료상담 실시



### 인프라 지원

사내 카페테리아 및 복카페 운영, 기숙사지원, 사내 어린이집 운영  
피트니스 클럽 운영, 사업장 별 셔틀버스 운행, 회사 콘도 지원



[고용노동부]  
“일자리 창출 유공 표창”

[고용노동부]  
“대한민국 일자리 으뜸기업 선정”

[산업통상자원부]  
“무역의 날 20억불 수출의 탑 수상”

[고용노동부]  
“장애인 고용 우수 사업주”

[한국장애인고용공단]  
“트루컴퍼니(장애인고용 신뢰기업) 금상”



인재경영 | 기술혁신 | 고객지향 | 상생경영

엠코코리아  
종합 QR코드



#국내1위

#반도체패키징&테스트

#Since1968

#나스닥상장



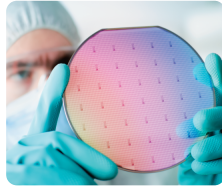
Enabling the Future

# 엠코코리아



# 최초에서 최고로 Global OSAT Leader

앰코테크놀로지코리아(주)(이하 앰코코리아)  
는 1968년 한국 기업 **최초**로 반도체 사업에  
착수한 아남산업이 그 전신입니다.



또한, **반도체 100년 기업**으로의 도약을 위해  
인천 송도에 세계 최고 수준의 R&D센터와  
최첨단 반도체 패키징 생산라인을 구축하며,  
전 세계 11개국 30,000여명의 임직원과 함께 세계시장 점유율을 1위로  
끌어올릴 준비를 하고있습니다.



특히, 4차 산업혁명으로 인해 반도체 패키징  
시장의 경쟁이 치열해지면서 앰코코리아는  
글로벌 경영 환경을 갖추고, 무결점 품질 등  
**차별화된 경쟁력**을 확보하고 있습니다.

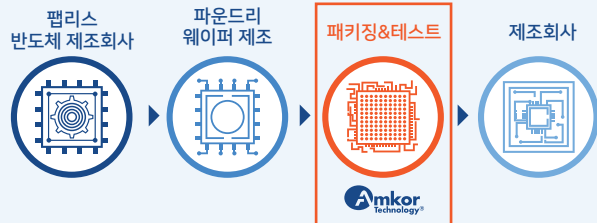
앰코코리아는 **적극적인 우수인재 채용**을 통해  
이러한 경쟁력을 더욱 강화하고 **회사와 임직원의  
동반성장**을 이끌고 있습니다.

## OSAT (Outsourced Semiconductor Assembly & Test)

반도체 산업은 간략하게 반도체를 설계하는 Fabless, 설계된 반도체를  
생산하는 Foundry, 생산된 웨이퍼를 **패키징하고 테스트**하는 **OSAT**으로  
구분됩니다.

앰코코리아는 반도체 후공정으로 불리는 **OSAT 시장에서 세계 최고의  
기술력**을 바탕으로 미래를 대비한 핵심 Advanced packaging 기술 -  
Heterogeneous & 3D Integration, System in Package, RF Module  
and System, Advanced logic, and RF test, 5G antenna, Automotive  
분야에서 **시장을 선도**하고 있습니다.

특히, 반도체 미세화에 따라 반도체 칩과 회로의 효율적인 배열, 적층  
방식의 개선을 통한 다기능 고집적 구현의 중요성은 계속해서 커져가고  
있으며, **Global OSAT Leader**인 앰코코리아는 **반도체 후공정 기술  
발전**을 **선도**하고 있습니다. 앰코코리아에 입사한다면 **Global 기업**의  
**구성원**으로서 미국, 유럽, 아시아 등 다양한 국가의 사람들과 일하게 되고  
해외파견 기회도 얻을 수 있습니다.



## Global Amkor



## 국내사업장



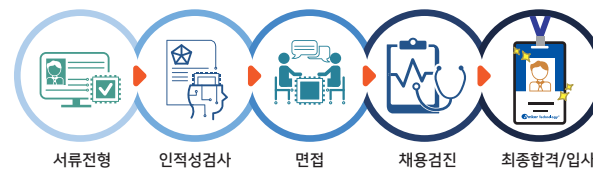
## 지원방법

앰코코리아 채용 홈페이지  
(<https://amkor.recruiter.co.kr/>)에서  
온라인 지원

앰코코리아  
종합 QR코드



## 전형절차



\*각 전형절차는 변경될 수 있으므로, 실제 입사지원 시 채용공고에서 확인

## 주요직무소개

| 직무                    | 업무내용                                                                                                                                 | 관련전공                                    |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| R&D                   | - 신규 제품개발 및 공정 관련 개발업무<br>- 고객의 Project 수행 및 기술적 대응                                                                                  | 공학, 자연계열                                |
| Process Engineer (PE) | - 반도체 Package 생산라인 최적화 공정 구축<br>- 고객요청을 실현하기 위한 기술지원 및 공정설계                                                                          | 공학, 자연계열                                |
| TEST Engineer (TE)    | - 반도체 디바이스 양산 TEST 지원<br>- TEST 환경 개발 및 신기술 도입                                                                                       | 공학, 자연계열<br>(전기, 전자 관련 우대)              |
| Quality Engineer (QE) | - 품질보증(품질 Issue 대응 및 예방)<br>- 원자재 품질관리<br>- 신뢰성 분석                                                                                   | 공학, 자연계열                                |
| 생산기획 (IE)             | - Capacity Planning<br>- System & Data Analysis<br>- 표준 설정 및 공정 관리화                                                                  | 전공무관<br>(산업공학 관련 우대)                    |
| 고객만족 (PCS)            | - 제조, 물류, 고객 Coordination<br>- Production Control<br>- 고객관리 및 Communication                                                          | 전공무관<br>(외국어 우수자 우대)                    |
| 구 매                   | - Substrate(PCB) 및 Other Direct Material (ODM) 구매, 조달<br>- Substrate, ODM 시장조사<br>- PO Planning 및 납기관리<br>- 가격협상과 신규업체 발굴 등 원가경쟁력 확보 | 전공무관<br>(외국어 우수자 우대)                    |
| 자동화                   | - 공장자동화에 필요한 장비 등 SW 개발                                                                                                              | 컴퓨터공학, 시스템공학<br>(장비자동화 SW 활용<br>가능자 우대) |
| 제조장비직 (Maint)         | - 제조장비 유지 및 보수관리<br>- 공정품질 및 Yield 향상<br>- 프로세스 개선 및 장비가동률 향상                                                                        | 전문학사 이공계열<br>(전기, 전자, 기계<br>관련 우대)      |
| 제조직 (Operator)        | - 반도체 패키징 및 제품생산<br>- 제품검사 및 품질검수<br>- 컴퓨터를 활용한 장비조작 등 업무                                                                            | 고졸 이상 전공무관                              |